

证券代码：002845

证券简称：同兴达

## 深圳同兴达科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20231107

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	国泰基金 宋巨生 君榕资产 陈宇 东海自营 易尚 中海基金 谈必成 璞远资产 魏来 国金证券 周焕博 浦银安盛基金 朱胜波 中银资管 周喆 博时基金 符昌铨 华西证券 胡杨 卜灿华	汐泰投资 袁淑文 人保资产 吴若宗 博鸿资产 蔡文吉 中海基金 姚炜 昊晟投资 郑哲婧 海南硕腾私募 赵世光 中邮证券 周莹 东财基金 罗挚 众安保险 徐赛
<b>时间</b>	2023年11月07日	
<b>地点</b>	公司子公司：昆山日月同芯半导体有限公司（现场参观调研）	
<b>上市公司接待人员姓名</b>	投资总监姚拥军 董秘李岑 昆山总经理胡明翊	
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司子公司昆山日月同芯半导体有限公司总经理胡明翊向所有投资者介绍了子公司基本情况，并陪同投资者实地参观。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、请问公司昆山工厂现在一期如果满产后，产量能达到多少？</p>	

答：公司昆山芯片金凸块（GoldBump）全流程封装测试项目计划分三期完工，预计其中一期满产后能实现产能 2 万片，二期满产后能实现累计 4 万片，三期视具体市场情况投入。

2、请问一期项目是否只涉及到 LCD 相关业务？OLED 业务有涉及到吗？

答：一期项目根据客户的实际需求开展业务，包括 LCD 及 OLED 相关业务，OLED 的相关业务收费相对更贵。

3、请问昆山子公司在半导体行业目前的优势是什么？

答：一是我们引进了日月新半导体（昆山）有限公司作为新股东，其丰富、成熟的技术和项目经验助力公司发展；二是公司采购目前市场上先进的生产设备，最大程度保证快速量产和产品良率；三是避开了友商同行的弯路，采用了更为先进的技术路线，提升了生产效率。

4、请问昆山目前生产设备已经全部进厂了吗？如此大规模的生产设备对于公司是否有资金压力？

答：目前一期机器设备还在铺设当中，预计明年二季度全部到位，昆山一期的资金公司通过各方面的努力没有缺口。

5、一期项目的投产节奏及满产带来营收利润规模？

答：根据公司内部测算，一期项目 2 万片产能预计在明年年底完成；在满产情况下，预计全年产生 6 亿左右的营业收入，1 亿左右的净利润。

6、请问公司在芯片先进封测项目上成本管控和现在的台湾比怎么样？目前的产品良率如何？

答：与台湾友商相比，公司在成本及人力等方面均有明显优势；目前产品良率约 99.9%。

7、在先进封测业务方向上，公司有什么具体规划？有涉及到 Chiplet 等封测技术吗？

答：凸块制造倒装技术是其他先进封测的基石，具备很强

	<p>的延展性。目前公司聚焦显示驱动芯片的全流程封测工艺，同时加强其他先进封测技术的研发储备，包括但不限于 Chiplet、cowos 封测技术等。</p> <p>8、昆山公司后期扩产的话，设备采购渠道会有限制吗？</p> <p>答：目前看显示驱动芯片的封测设备不在限制范围之内，而且国产化的设备正在逐步渗透中，潜力巨大。</p> <p>9、请问对显示驱动芯片封测业务前景怎么看？是否会出现产能过剩进入红海市场现象？</p> <p>答：显示驱动芯片产业链跟随液晶显示面板产业链本土化的趋势非常明显，大陆的显示驱动芯片封测业务将蓬勃发展，中长期看我们保持乐观。</p> <p>10、请问在客户导入端我们有什么优势？</p> <p>答：目前昆山封测基地的主要目标客户是集团液晶显示模组事业群的供应商，包括但不限于联咏科技和奕力科技等，双方深度合作超过十年以上，为昆山封测业务的顺利导入奠定了良好基础。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 11 月 7 日